

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金、天风证券共 5 人
时间	2025 年 2 月 19 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司主要竞争优势有哪些？</p> <p>A1：公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。</p>

公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势，实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。

Q2：公司未来如何规划？

A2：公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。

Q3：公司在三折屏供应链中有哪些布局？

A3：公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。

Q4：公司在 VR/AR/MR 显示领域有何布局？

A4：公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。

Q5：公司在半导体领域主要生产哪些设备？

A5：公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q6：公司主要采用什么样的研发模式？

A6：公司主要采取自主研发模式，拥有经验丰富、创新能力强、稳定的专业研发队伍，形成了完善的研发创新体系和稳固的知识产权保护体系。公司坚持以技术创新和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，主要

	采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式。
附件清单（如有）	无
日期	2025-2-19